

武汉力源信息技术股份有限公司

关于公司为全资子公司（孙）公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足全资子公司（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月8日、3月25日召开董事会、股东大会审议通过《关于2024年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币20.80亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于2024年3月9日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容

在上述已批准的担保额度项下，近日公司已分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《最高额保证合同》，其中为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供2000万元担保，为全资子公司武汉芯源半导体有限公司（以下简称“芯源半导体”）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供1000万元担保。同时，鼎芯无限、芯源半导体均对公司提供了等值的反担保。

1、公司为鼎芯无限提供担保签订的最高额保证合同主要内容如下：

①最高保证限额：2000万元。

②保证范围：为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写贰仟万元整)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、

差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。

③**保证方式**：连带责任保证担保。

④**被担保债务的履行期**：为主合同订立日(或主合同项下具体业务发生之日，以较早的为准)起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日，具体以主合同为准。

2、公司为芯源半导体提供担保签订的最高额保证合同主要内容如下：

①**保证最高本金限额**：1000万元。

②**保证方式**：连带责任保证。

③**保证范围**：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

④**保证期间**：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年，及其他有关期间的约定。

三、累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币 5.20 亿元（均系公司为全资子公司（孙）公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.40%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1、公司与各银行签订的《最高额保证合同》；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024年7月2日